



## Intel® Core™ M-5Y10c Processor

4M Cache, up to 2.00 GHz

### Niezbędne zasoby

- Kolekcja produktów [Procesory Intel® Core™ M piątej generacji](#)
- Nazwa kodowa [Nazwa Broadwell poprzednich produktów](#)
- Segment rynku pionowego Mobile
- Numer procesora 5Y10c
- Stan Launched
- Data rozpoczęcia Q4'14
- Litografia 14 nm
- Rekomendowana cena klienta N/A

### Wydajność

- Liczba rdzeni 2
- Liczba wątków 4
- Bazowa częstotliwość procesora 800 MHz
- Maks. częstotliwość turbo 2,00 GHz
- Cache 4 MB
- TDP 4,5 W
- Moc znamionowa dla scenariusza użycia (SDP, Scenario Design Power) 3,5 W
- Konfigurowalna częstotliwość TDP-up 1,00 GHz
- Konfigurowalny tryb TDP-up 6 W
- Konfigurowalna częstotliwość TDP-down 600 MHz
- Konfigurowalny tryb TDP-down 3,5 W

### Informacje uzupełniające

- Dostępne opcje rozwiązań wbudowanych Nie
- Dane katalogowe [Wyświetl teraz](#)

### Dane techniczne pamięci

- Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci) 16 GB
- Rodzaje pamięci LPDDR3 1333/1600; DDR3L/DDR3L-RS 1600
- Maks. liczba kanałów pamięci 2
- Maks. przepustowość pamięci 25,6 GB/s
- Obsługa pamięci ECC † Nie

### Grafika wbudowana w procesor

- Układ graficzny procesora † Intel® HD Graphics 5300
- Częstotliwość podstawowa układu graficznego 300 MHz

- Maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego 800 MHz
- Maks. pamięć wideo układu graficznego 16 GB
- Wyjście do grafiki eDP/DP/HDMI
- Maks. rozdzielczość (HDMI 1.4)‡ 2560x1600@60Hz
- Maks. rozdzielczość (DP)‡ 2560x1600@60Hz
- Obsługa DirectX\* 11.2/12
- Obsługa OpenGL\* 4.3
- Intel® Quick Sync Video Tak
- Technologia Intel® InTru™ 3D Tak
- Interfejs Intel® Flexible Display (Intel® FDI) Tak
- Technologia Intel® Clear Video HD Tak
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy † 3
- Identyfikator urządzenia 0x161E

## Opcje rozszerzeń

- Wersja PCI Express 2.0
- Liczba konfiguracji PCI Express † x1 (6), x2 (4), x4 (3)
- Maksymalna liczba linii PCI Express 12

## Specyfikacja obudowy

- Obsługiwane gniazda FCBGA1234
- Maks. konfiguracja procesora 1
- T<sub>JUNCTION</sub> 95 C
- Wymiary obudowy 30mm x 16.5mm

## Technologie zaawansowane

- Technologia Intel® Turbo Boost † 2.0
- Intel® vPro™ — kryteria kwalifikowalności platformy † Nie
- Technologia Intel® Hyper-Threading † Tak
- Technologia Intel® Virtualization (VT-x) † Tak
- Technologia Intel® Virtualization for Directed I/O (VT-d) † Tak
- Technologia Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) † Tak
- Intel® TSX-NI Nie
- Intel® 64 † Tak
- Zestaw instrukcji 64-bit
- Rozszerzony zestaw instrukcji Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
- Stany bezczynności Tak
- Udoskonalona technologia Intel SpeedStep® Tak
- Technologie monitorowania chłodzenia Tak
- Intel® Fast Memory Access Tak
- Intel® Flex Memory Access Tak
- Technologia Intel® ochrony tożsamości † Tak
- Program stabilnych platform firmy Intel® ułatwiających pracę administratorom Nie
- Technologia Intel® Smart Response Tak

## Niezawodność i bezpieczeństwo

- Intel® AES New Instructions Tak
- Secure Key Tak
- Technologia Intel® Trusted Execution † Nie

- Funkcje Execute Disable Bit : Tak
- Intel® OS Guard Tak